



4/24-26, 2024
南港展覽館一館 4F

電子生產製造設備展

Electronic Equipment Exhibition

匯聚設備產業之能量 共同打造完整供應鏈

半導體封裝與自動化 | 化合物半導體 | 電子生產製造 | 電池生產製造

展覽介紹



同期展出：
touch TAIWAN SMART+

半導體封裝與
組裝設備



半導體智動化
解決方案



化合物半導體設備



Micro LED
生產製造設備



電池生產製造設備



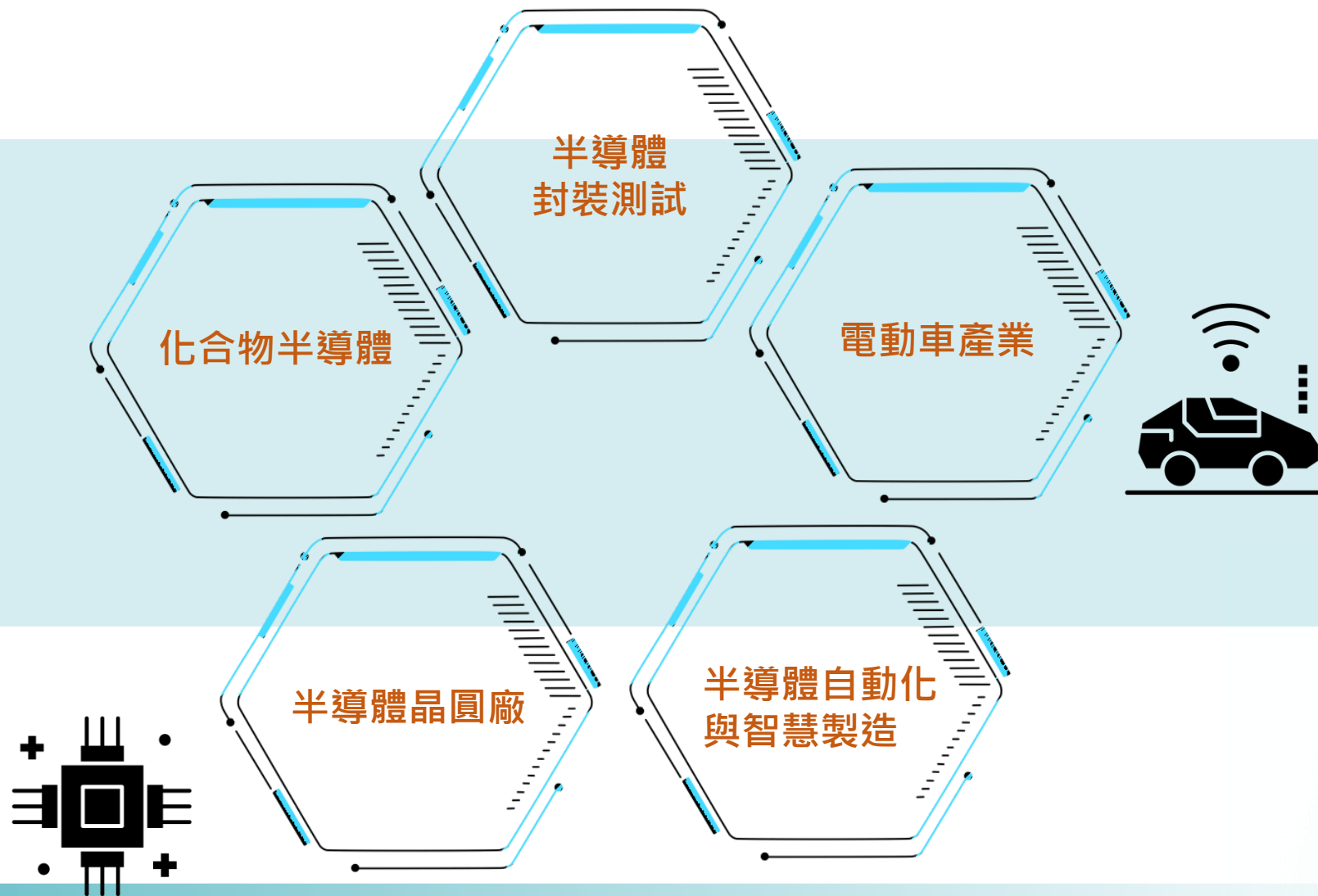
電子設備關鍵模
組/零組件



電子生產製造設備



目標族群





*僅列出部分媒體單位

- 展覽邀請函
- 電子報
- 合作單位會員
- 簡訊



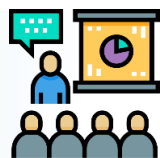
直效行銷



網路廣告

- 官方網站
- 合作單位網站
- 關鍵字廣告
- 社群網站廣告

- 展前Roadshow
- 化合物半導體國際論壇



B2B 專業論壇



媒體

- 電視台
- 報紙
- 產業刊物
- 戶外廣告

- 國際產業公協會/商會
- 政府駐外單位
- 相關產業展覽推廣
- 國際網路廣告投放



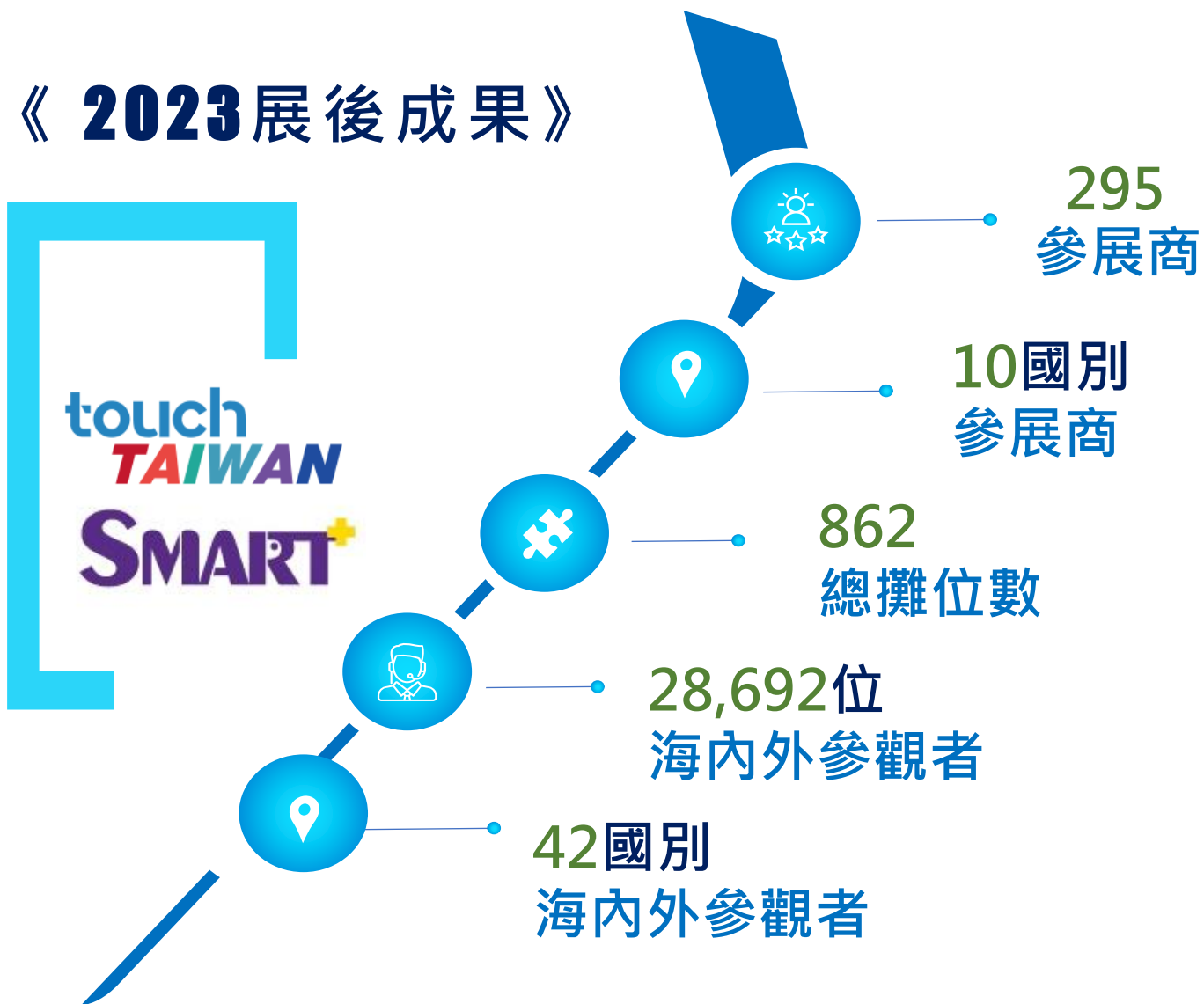
國際宣傳



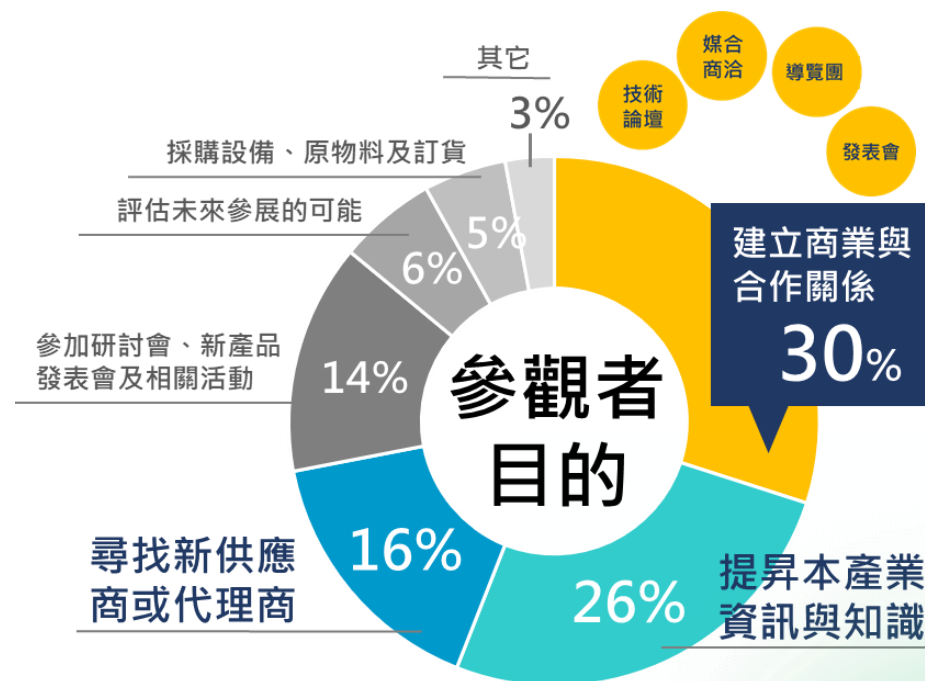
買主導覽

- 國內外買主邀請
- 產業公協會
- 學校單位

《 2023 展後成果 》



《 參觀者目的 》



攤位規格	原價	早鳥價至8/31	會員價
淨空地攤位	53,000	50,000	47,000
標準裝潢攤位	57,500	54,500	51,500
主題館攤位	63,000	60,000	57,000

凡加入TDUA、TEEIA、TPSA、TDMDA、SID會員可享會員優惠價。

標準裝潢配備 (大會代辦基本裝潢) 每一個攤位費用為NT\$ 4,500 (未稅)。

標準裝潢攤位: 配備包括三面隔間牆、三盞投射燈、110V插座一個、地毯一張 (9平方米)、公司招牌一組及接待桌椅各一張。

4.主題館攤位:基本隔間(3M*3M)、地毯(淺灰)、接待桌輸出(96.7*66)、接待桌(100*50*H75)、玻璃圓桌(DIA75)*1、折椅(黑色)*4、13WLED、長臂燈_白光*6、110V/5A插座*1。

5.動力用電、24小時供電、配置水管用水、空壓機及堆高機作業，須依收費標準繳費。

標準裝潢示意



主題裝潢示意



化合物半導體國際論壇 贊助方案

項目內容		銀級	金級
演講 (主辦單位保留安排議程與時間“30分鐘”權利) * 海外講師可使用線上直播或錄影檔案		無	○
TEEIA官網首頁	專屬banner輪播 *30天(含假日)	○	○
網路曝光	公司介紹文 *Facebook : 1圖+文字200內	○	○
	會後報導(含外稿記者)	無	○
論壇講義封面/內頁/(公司 Logo/介紹)		○	○
會場佈置看板Logo		○	○
特製看板(100x200cm)		無	○
企業瓶裝水(24瓶/10箱)		無	○
論壇VIP公關票		2張	5張
化合物半導體供應鏈之夜 門票		1張	2張
原價(不含營業稅)		NT \$ 20萬	NT \$ 40萬
參展商、會員優惠價(不含營業稅)		NT \$ 15萬	NT \$ 30萬

■主辦單位保留變更內容之權利

■金級or銀級之贊助廠商，將於化合物半導體供應鏈之夜頒發獎牌一座

■詳細贊助方案請洽主辦單位：02-2729-3933#12 doris@teeia.org.tw

化合物半導體晚宴 贊助方案

贊助項目	主辦單位提供配套	贊助費用	贊助商數量
化合物半導體 供應鏈之夜	<ul style="list-style-type: none"> ■ TEEIA官網首頁：專屬banner輪播 (30天/含假日) ■ 品牌曝光：會議開始前及休息時間播放3分鐘宣傳片(影片檔由贊助廠商自行提供) ■ 大會主背板Logo曝光 ■ 贊助單位推派代表上台致詞(5分鐘內) ■ 論壇VIP公關票 名額5人 ■ 化合物半導體供應鏈之夜 門票2張 ■ 晚宴規模：80人 	NT\$ 40萬 (不含營業稅)	單一企業冠名贊助



■主辦單位保留變更內容之權利

■金級or銀級之贊助廠商，將於化合物半導體供應鏈之夜頒發獎牌一座

■詳細贊助方案請洽主辦單位：02-2729-3933#12 doris@teeia.org.tw

支持企業



歷屆講師陣容大集合



莊淵棋 副總經理
GaN Systems



程泰慶 經理
漢磊科技



許至全 銷售及市場部副總裁
亞太區(不含中國) Wolfspeed



謝智正 處長
尼克森微電子



陳文聰 亞太區功率元件技術行銷經理
意法半導體



郭浩中 講座教授
國立陽明交通大學



劉建廷 業務經理
迪思科高科技



林柏丞 執行長特助
盛新材料



張家棟 經理
ULVAC



魏致祺 資深協理
英飛凌



李宏益 行銷事業群總經理
辛耘企業



李坤彥 創辦人
碳矽電子



Melbs LeMieux
聯合創辦人/總裁
Electroninks



江明松 應用工程經理
安森美半導體



Walter Schwarzenbach
PhD. Soitec



方建雄 總經理
PALLIDUS



邱建維 副處長
世界先進



Claire Troadec Director,
Power & Wireless
Yole Développement



4/24-26, 2024

南港展覽館一館 4F

電子生產製造設備展

Electronic Equipment Exhibition

匯聚設備產業之能量 共同打造完整供應鏈

半導體封裝與自動化 | 化合物半導體 | 電子生產製造 | 電池生產製造

謝謝聆聽



聯絡
窗口

台灣電子設備協會(TEEIA)

林小姐 (02) 2729-3933#12

doris@teeia.org.tw

管小姐 (02) 2729-3933#15

joanna@teeia.org.tw